

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

617

ML4

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

18.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	330		2	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		4	
C-RS-FR4-ML-0.51mm-105+105-TG150-HF	50200884	105	L2		
		510		5	
		105	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	330		6	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7	
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		8	
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	9	

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1450 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik